tML® - Teilfrontplatte mit 12x MPO/MTP® Typ B (Key Up/Up) für Modulträger 1HE ausziehbar



tML® Xtended

tML®Xtended ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-und-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP®12 Faser - und Telco-Steckverbinder, über die sechs Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind mit SR4 derzeit Übertragungsraten von bis zu 200G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML®-Verkabelungssystem als bewährtes tML® Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML® 24 System sowie neu als tML® 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Die tML®– LWL Teilfrontplatte ist für den Einbau im 1HE tML® - Modulträger ausziehbar (für 8 x Module) vorgesehen.. Die tML® HD Teilfrontplatte kann nur zusammen mit dem tML® HD Patchkabel eingesetzt werden.

tde® trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:
Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:
Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

 © tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.

tML® - Teilfrontplatte mit 12x MPO/MTP® Typ B (Key Up/Up) für Modulträger 1HE ausziehbar

Technische Daten

Bestückung	12 x MPO/MTP® Adapter (grau)
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

tML® - Teilfrontplatten

Frontplatte	Edelstahl
Abmessungen	108 x 20 mm

LWL Adapter

Typ	MPO/MTP®
Anwendung	Multimode OM1/OM2
Bauform	ohne Flansch
Einbauform	SC Simplex
Orientierung	Typ B, Key up/up
Farbe	Grau
Material	Kunststoff
Hülse	--
Klappe	--
Standards	IEC 61754-7 TIA 604-5
Hersteller	US Conec

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-M12MP-GN-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 12x MPO/MTP® Typ A (Key Up/Down) OS2 Grün für Modulträger 1HE ausziehbar
TML-M12MP-GR-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 12x MPO/MTP® Typ B (Key Up/Up) für Modulträger 1HE ausziehbar
TML-M12MP-LG-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 12x MPO/MTP® Typ A (Key Up/Down) OM5 Limegreen für Modulträger 1HE ausziehbar
TML-M12MP-TK-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 12x MPO/MTP® Typ A (Key Up/Down) OM3 Aqua für Modulträger 1HE ausziehbar
TML-M12MP-VI-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 12x MPO/MTP® Typ A (Key Up/Down) OM4 Magenta für Modulträger 1HE ausziehbar

© tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.